

# AY-LDC1000\_用户手册

杭州艾研信息技术有限公司

2014 年 11 月

## 申明

杭州艾研信息技术有限公司保留随时对其产品进行修正、改进和完善的权利，同时也保留在不作任何通告的情况下，终止其任何一款产品的供应的权利。用户在下订单前应及时获取相关信息的最新版本，并验证这些信息是当前的和完整的。

可通过如下方式获取最新信息、技术资料和技术支持：

技术支持电话：0571-86134572

技术支持邮箱：support@hpati.com

产品&资料下载中心：<http://www.hpati.com/products/>

互动论坛：<http://www.hpati.com/bbs/forum.php>

公司地址：浙江省杭州市西湖区留和路16号新峰商务楼B402

更多资讯请添加艾研信息官方微信（搜索公众号：艾研）或扫一扫下方二维码：



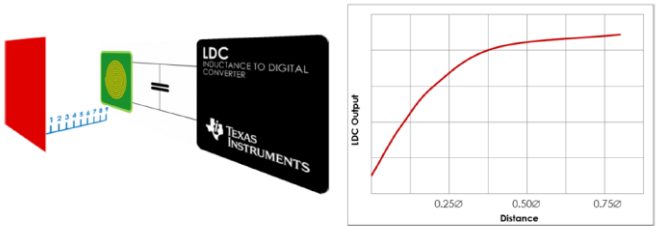
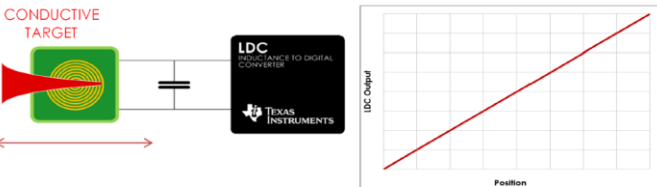
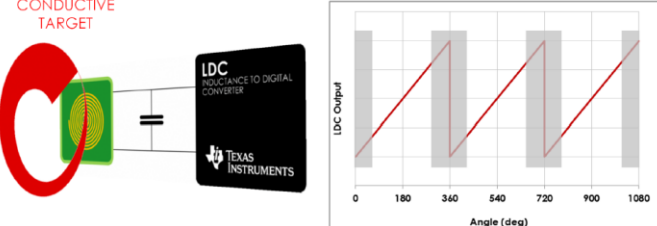
## 目录

1	LDC1000 简介.....	2
2	单片机连接 LDC1000.....	3
2.1	硬件连接.....	3
2.2	使用 F5529LP 控制 LDC1000.....	4
2.2.1	程序下载.....	4
2.2.2	SPI 通讯.....	6
	SPI 初始化.....	6
	SPI 读写.....	7
2.2.3	SPI 扩展通信模式.....	8
2.2.4	数据处理.....	9
2.3	使用 TivaM4 控制 LDC-1000.....	9
2.3.1	程序下载.....	10
2.3.2	函数说明.....	13
3	寄存器设置及数据处理.....	16
3.1	RpMIN 和 RpMAX 值设定.....	16
3.2	Rp 值计算公式.....	16
3.3	电感计算公式.....	16
3.4	输出数据速率.....	17
4	电路设计注意点.....	17
4.1	滤波电容选择（CFA 和 CFB 管脚管脚间）.....	17
4.2	EVM 板掰开的方式.....	18
5	附录.....	18
5.1	LDC1000 电感检测原理.....	18
5.2	使用 LDC1000 测量并联谐振阻抗和电感.....	20
5.3	参数计算.....	22
5.3.1	Rp 的 Min 和 Max 值计算.....	22
5.3.2	Rp 的 Min 和 Max 值电路意义分析.....	23
6	原理图.....	24

## 1 LDC1000 简介

LDC1000 是世界首款电感到数字转换器。提供低功耗，小封装，低成本的解决方案。它的 SPI 接口可以很方便连接 MCU。LDC1000 只需要外接一个 PCB 线圈或者自制线圈就可以实现非接触式电感检测。LDC1000 的电感检测并不是指像 Q 表那样测试线圈的电感量，而是可以测试外部金属物体和 LDC1000 相连的测试线圈的空间位置关系。

利用 LDC1000 这个特性配以外部设计的金属物体即可很方便实现：水平或垂直距离检测；角度检测；位移监测；运动检测；振动检测；金属成分检测（合金检测）。可以广泛应用于汽车、消费电子、计算机、工业、通信和医疗领域。

典型应用	说明
 <p>Figure 21. Axial Distance Measurement</p>	<p>纵向距离测量。红色是金属片。</p>
 <p>Figure 22. Linear Position Sensing</p>	<p>横向距离测量。红色是金属片。</p>
 <p>Figure 23. Angular Position Sensing</p>	<p>转动角度测量。红色是金属片。</p>

## 2 单片机连接 LDC1000

### 2.1 硬件连接

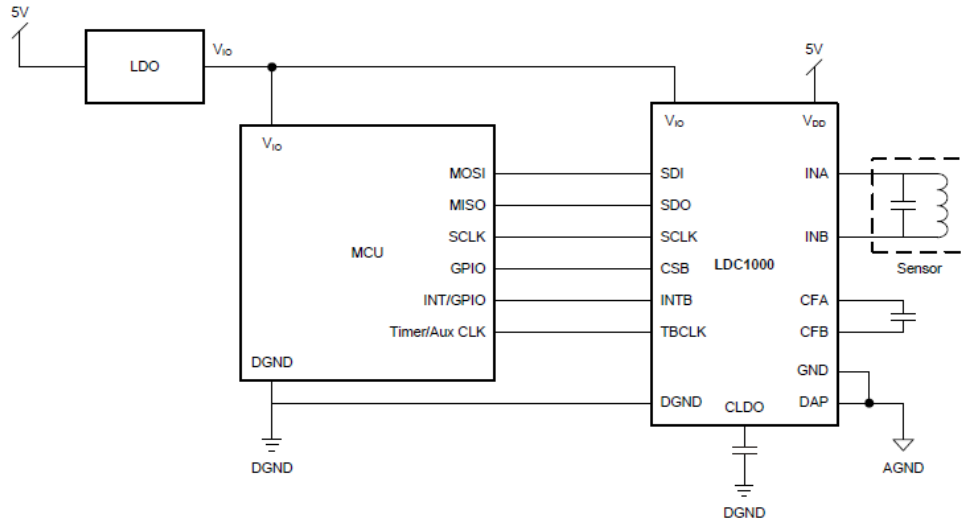


图 1 LDC1000 与 MCU 的连接原理图

LDC-1000 与 MCU 的连接原理图如图 1 所示。采用了四线制 SPI 连接方式，信号线的具体定义如表 1 所示。MCU 通过 SPI 连接（SDI、SDO、SCLK、CSB）实现对 LDC-1000 的控制，以及数据读取。在 SPI 通信过程中，LDC-1000 扮演从机（Slave）的角色。

## 2.2 使用 F5529LP 控制 LDC1000

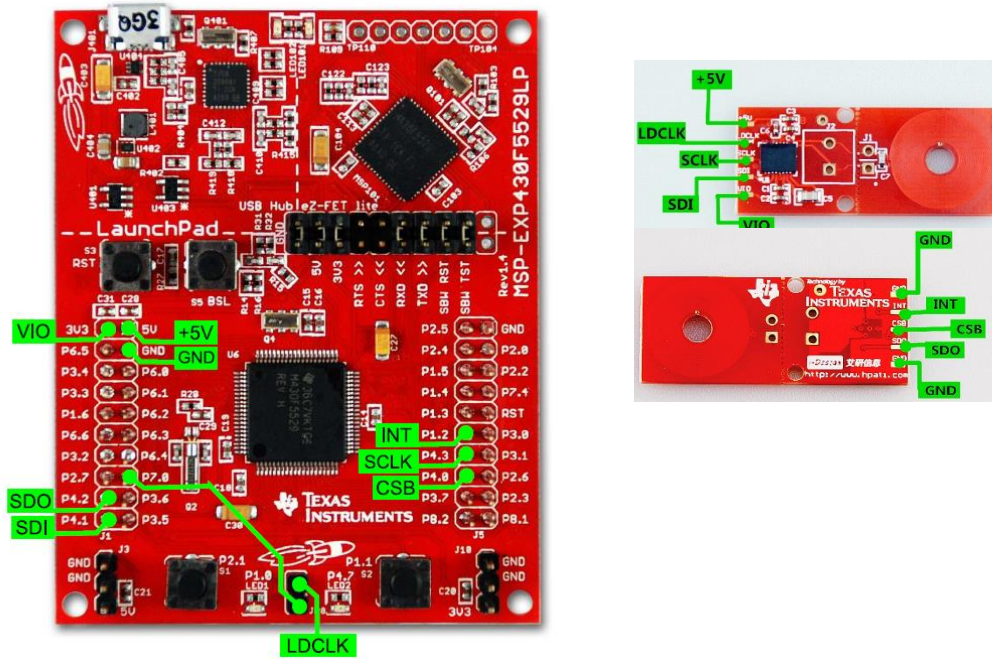


图 2 MSP430F5529 LaunchPad 控制 LDC1000

表 1 与 5529 相连的 数据管脚定义表接口

LDC-1000 接口	F5529LP 接口	图 1 中的 MCU 接口	说明
SDO	P4.2/UCB1SOMI	MISO	SPI 数据输出
SDI	P4.1/UCB1SIMO	MOSI	SPI 数据输入
SCLK	P4.3/UCB1CLK	SCLK	SPI 时钟信号
CSB	P4.0/UCB1STE	GPIO	从设备使能信号
INT	P1.2	INT/GPIO	中断接口
TBCLK	P1.0/ACLK	Timer/Aux CLK	频率计数时钟频率
VIO	3V3		供电接口
+5V	5V		
GND	GND		
NA	P7.0		红色 LED
NA	P1.1		绿色 LED

### 2.2.1 程序下载

按上述描述进行硬件连接，连接时可先焊接 2\*5 的双排排母（EVM 包装袋中自带）到 EVM 板上，再用杜邦线将排母连接到 F5529LP 的相应管脚上，连接完成后，用万用表测试连通性。确保连通性后再通过 USB 线将 F5529LP 与电脑连接。如果是第一次连接 F5529LP 到电脑，将会出现驱动安装的提示，安装驱动（若后续 CCS 下载程序时提示找不到设备，检查驱动是否安装完成）。如正确安装驱动，在 Windows 系统的设备管理器中会看到如图 3 设备管理器标识：

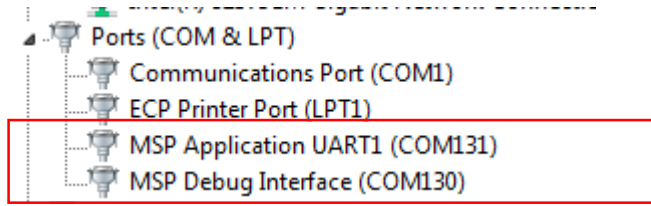


图 3 设备管理器

2、打开 CCS (V5 版本), 单击 “Project->Import existing CCS eclipse project ”, 如图 4 所示。选择实验例程所在的文件夹, 将示例工程导入 (图 5)。注意: 实验例程所在的文件夹的目录不能有中文字符, 因为 CCS 只接受 8 位 ASCII 的文件名及文件路径。

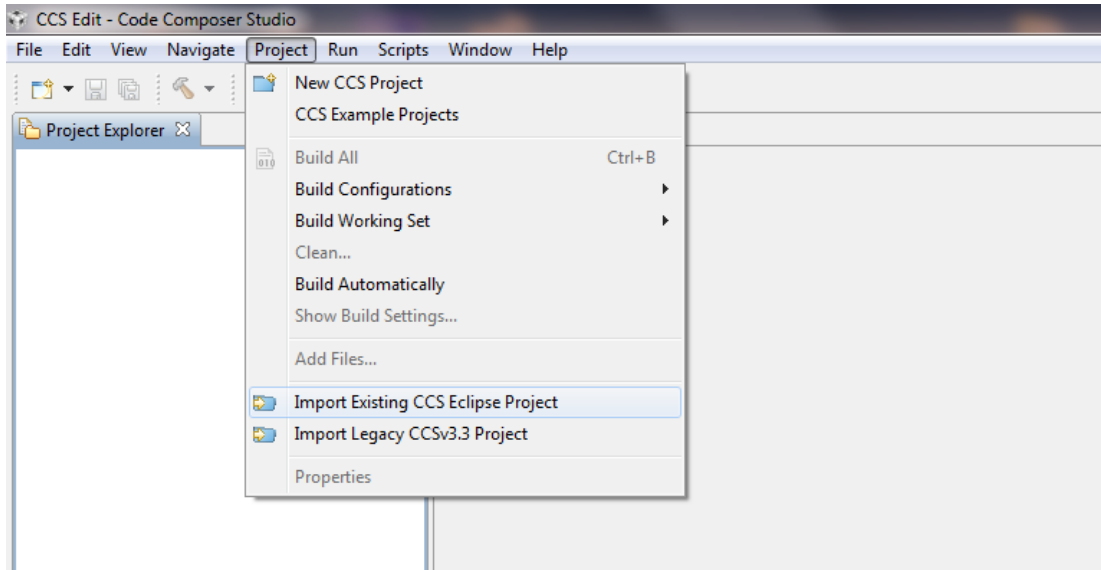


图 4 导入工程的菜单选项

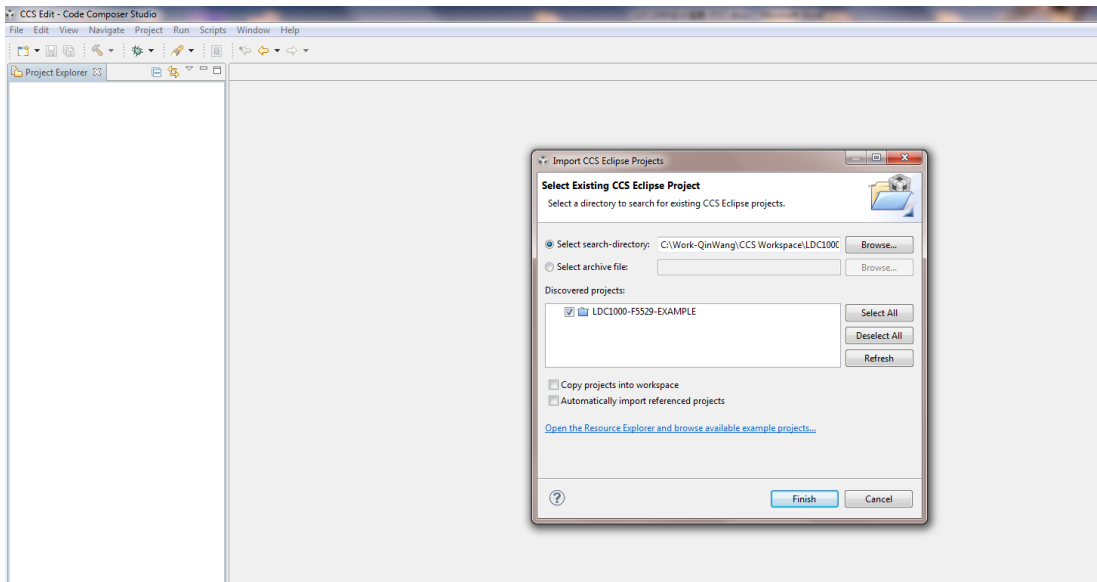


图 5 导入 LDC1000 例程

3、在工程项目上, 右击, 点击 “Build Project” 编译 (图 6)

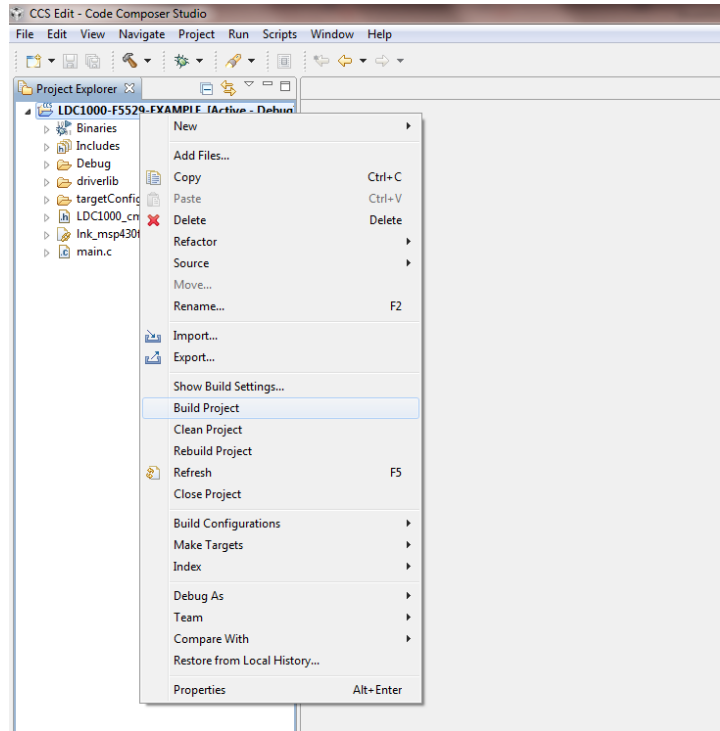


图 6 Build Project

4、单击“Debug”将程序下载至板卡，单击“Run”运行代码(图 7)。

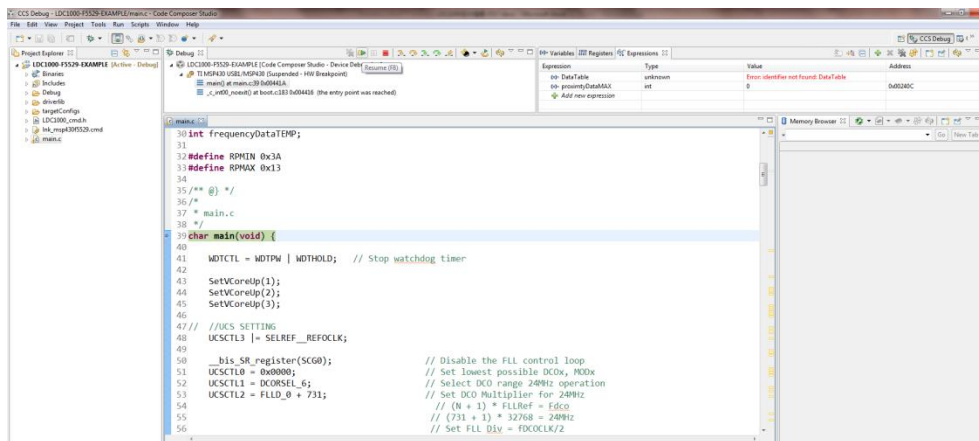


图 7 Debug

## 2.2.2 SPI 通讯

LDC1000 与 F5529 的通讯接口为 SPI，F5529LP 有多组 SPI 接口，我们选用了其中的 UCB1 的那一组，参考以下步骤进行配置。如果选用 F5529 中的其它组的 SPI 接口可参考下面步骤进行相似配置。

### SPI 初始化

使用 F5529 硬件 SPI 模块，按照所选择模块引脚对 SPI 进行配置，基本步骤如下所示，更多可参考”MSP430x5xx/MSP430x6xx Family User’s Guide”(SLAU208J)-Chapter 33:

```

// initialize SPI
P4DIR |= BIT0; // CS引脚功能和方向选择，为IO口
P4SEL &= ~BIT0;

//SPI SETUP
    
```



```
P4SEL |=BIT1 + BIT2 + BIT3;           //SOMI,SIMO,CLK引脚功能选择
UCB1CTL1 |=UCSWRST;
UCB1CTL0 |= UCMST+UCMSB+UCSYNC+UCCKPL;
                //SPI工作模式配置,3线SPI,8位数据,主机,MSB优先
UCB1CTL1 |= UCSSEL_1;                 //选择SPI模块的时钟
UCB1BR0 = 0x06;
UCB1BR1 = 0;                          //对时钟进行分频
UCB1CTL1 &= ~UCSWRST;
```

## SPI 读写

在参考程序中定义了如下所示的几个函数，可直接进行 SPI 的读写。

SPI读，读取指定地址寄存器的值。其中传递参数addr为从机读数据的地址，8位；data为读取到的寄存器值保存的地址指针；len为读取的字节数/次数

```
char spi_readByte( char addr, char * data);    //单字节读取
char spi_readWord(char addr, unsigned int * data); //双字节读取
char spi_readBytes( char addr, char * buffer, char len); //多字节读取
```

SPI写，向指定寄存器写入控制值。其中传递参数addr为从机写入数据的地址，8位；data为写入到的寄存器值保存的地址指针；len为写入的字节数/次数

```
char spi_writeByte(char addr, char data);      //单字节写入
char spi_writeWord(char addr, unsigned int data); //双字节写入
char spi_writeBytes( char addr, char * buffer, char len); //多字节写入
```

对上述函数进行调用时，函数参数值的选定应根据 LDC1000 的 SPI 通信协议（即 SPI 通信的时序，时序图如图 8 所示）。在主机(MSP430)与从机(LDC1000)通讯的时候，遵循以下步骤：

1. 片选信号置零；
2. MSP430 通过 SDI 线向 LDC1000 写入访问寄存器地址，其中最高位 0 表示写入，1 表示读出，剩余 7 位为寄存器的地址；
3. 步骤 2 过程占据 8 个时钟周期，该时间内 SDO 线处于高阻状态；
4. 如果命令为读，即步骤 1 中传输的数据最高位为 1，SDO 线上发送来自其地址寄存器的 8 位字节；
5. 如果命令为写，SDI 线接收来自 MSP430 的 8 位字节数据写入相应的寄存器中；
6. 片选信号置高，释放对该从机的控制。

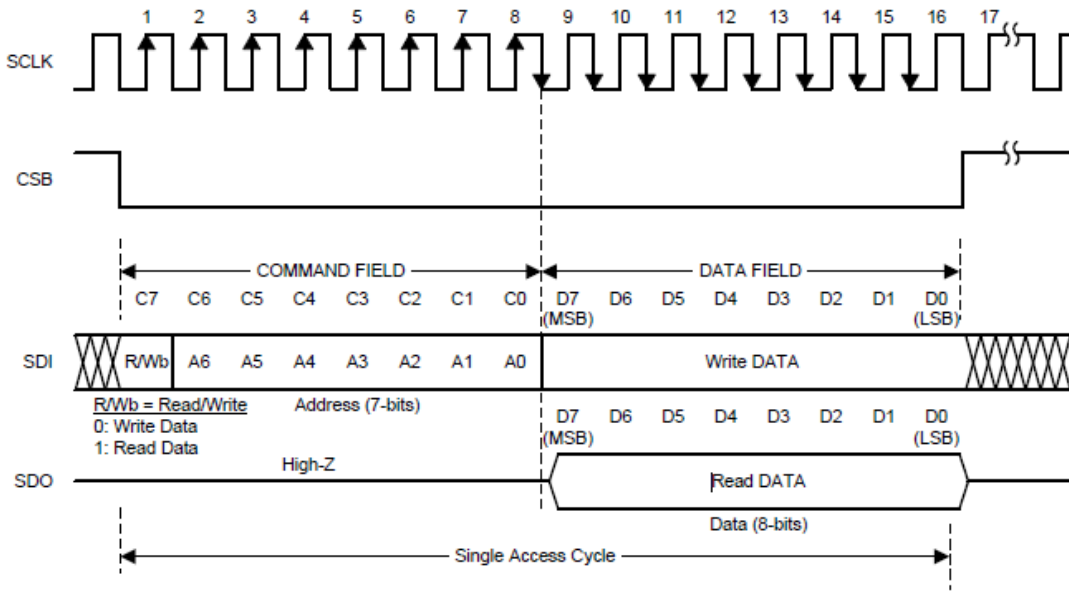


图 8 LDC1000 SPI 读写时序

片选信号 CSB 的置位意味着新的寄存器访问。数据输出在时钟的下降沿发生，数据的写入在时钟的上升沿发生。需要注意，片选信号的复位必须保证在数据读取/写入完全完成后，即第 16 个时钟的上升沿，否则该次数据的读写无效。

LDC1000\_cmd.h 内对 LDC1000 的寄存器地址及对应的位进行了定义。在编写程序时可以进行参考。

```
#define LDC1000_CMD_REVID      0x00
#define LDC1000_CMD_RPMAX     0x01
#define LDC1000_CMD_RPMIN     0x02
#define LDC1000_CMD_SENSORFREQ 0x03
#define LDC1000_CMD_LDCCONFIG 0x04
#define LDC1000_CMD_CLKCONFIG 0x05
#define LDC1000_CMD_THRESHILSB 0x06
#define LDC1000_CMD_THRESHIMSB 0x07
#define LDC1000_CMD_THRESLOLSB 0x08
#define LDC1000_CMD_THRESLOMSB 0x09
#define LDC1000_CMD_INTCONFIG 0x0A
#define LDC1000_CMD_PWRCONFIG 0x0B
#define LDC1000_CMD_STATUS     0x20
#define LDC1000_CMD_PROXLSB    0x21
#define LDC1000_CMD_PROXMSB    0x22
#define LDC1000_CMD_FREQCTRLSB 0x23
#define LDC1000_CMD_FREQCTRMID 0x24
#define LDC1000_CMD_FREQCTRMSB 0x25
```

### 2.2.3 SPI 扩展通信模式

LDC1000 支持 SPI 的扩展通信模式，可实现对多个寄存器连续访问。具体方法为保持片选信号有效，进行连续的读/写，此时寄存器的地址会自动增加。在  $8*(1+N)$  个时钟周期后将片选信号复位即可。例程中的多字节写入/读取即实现了这样的功能。

```
spi_readBytes(LDC1000_CMD_FREQCTRLSB,&frequencyData[0],3);
```

## 2.2.4 数据处理

```

//read all REG value using default setting
char orgVal[20];

//write to register
spi_writeByte(LDC1000_CMD_RPMAX,      RPMAX);
spi_writeByte(LDC1000_CMD_RPMIN,      RPMIN);
spi_writeByte(LDC1000_CMD_SENSORFREQ, 0x94);
spi_writeByte(LDC1000_CMD_LDCCONFIG,  0x17);
spi_writeByte(LDC1000_CMD_CLKCONFIG,   0x02);
spi_writeByte(LDC1000_CMD_INTCONFIG,   0x02);

spi_writeByte(LDC1000_CMD_THRESHILSB,  0x50);
spi_writeByte(LDC1000_CMD_THRESHIMSB,  0x14);
spi_writeByte(LDC1000_CMD_THRESLOLSB,  0xC0);
spi_writeByte(LDC1000_CMD_THRESLOMSB,  0x12);

spi_writeByte(LDC1000_CMD_PWRCONFIG,   0x01);

//read all registers using extended SPI

spi_readBytes(LDC1000_CMD_REVID, &orgVal[0],12);
    
```

在例程中对 LDC1000 的读写如上图所示。首先依次按照设定对 LDC1000 的寄存器写入对应的控制字(可参考 LDC1000datasheet 中关于寄存器的描述)。利用例程提供的 spi\_readBytes 函数可以一次性将所有寄存器内的值全部读出。

其中用户关心两个值, Rp 和 Frequency, 通过前者我们可以推算出金属的距离, 而后者可以计算得到电感值。

```

spi_readBytes(LDC1000_CMD_PROXLSB,&proximtyData[0],2);
spi_readBytes(LDC1000_CMD_FREQCTRLSB,&frequencyData[0],3);

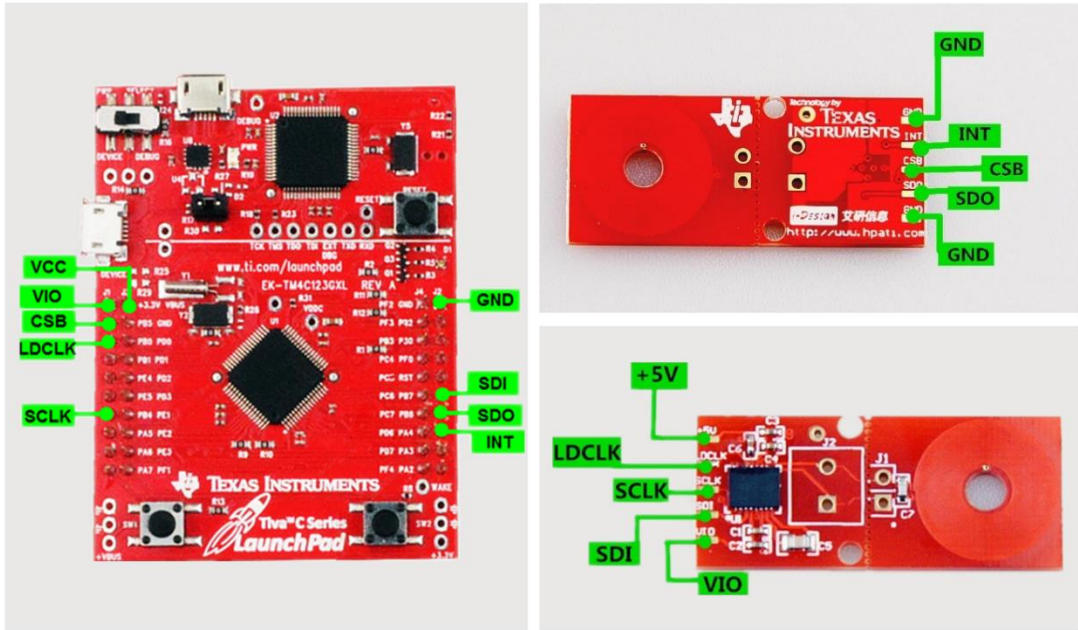
proximtyDataMAX = ((unsigned char) proximtyData[1]<<8) +
                  proximtyData
[0];
frequencyDataMAX = ((unsigned char) frequencyData[1]<<8) +
                  frequencyData[0];
    
```

而 Rp 和 frequency 分别占用了 2 个和 3 个寄存器, 也就是说 Rp 为 16 位, Frequency 为 24 位。用户可以参考例程的方法分别读取完整的等效电阻和频率值。注意, 例程中仅读取了频率的低 16 位。

具体 Rp 与电感的计算方法及公式参考本文档 3 [寄存器设置及数据处理](#) 章节。

## 2.3 使用 TivaM4 控制 LDC-1000

TIVA 控制 LDC1000 的硬件连接如下图所示。



LDC-1000 接口	TIVA LP 接口	说明
SCLK	PB4/SPICLK	SPI 时钟信号
CSB	PB5/SPICS	从设备使能信号
SDI	PB7/SPIMOSI	SPI 数据输入
SDO	PB6/SPIMISO	SPI 数据输出
INT	PA4	中断接口
LDCLK	PB0	频率计数时钟频率
VIO	3V3	供电接口
+5V	VBUS	
GND	GND	

### 2.3.1 程序下载

按上述方法连接 M4Launchpad 与 LDC1000，将 Launchpad 上的 power select switch 切到右侧。通过 USB 连接电脑。打开 CCS，单击“Project->Import existing CCS eclipse project”，选择实验例程所在的文件夹，将示例工程导入。注意：路径中不能有中文字符。

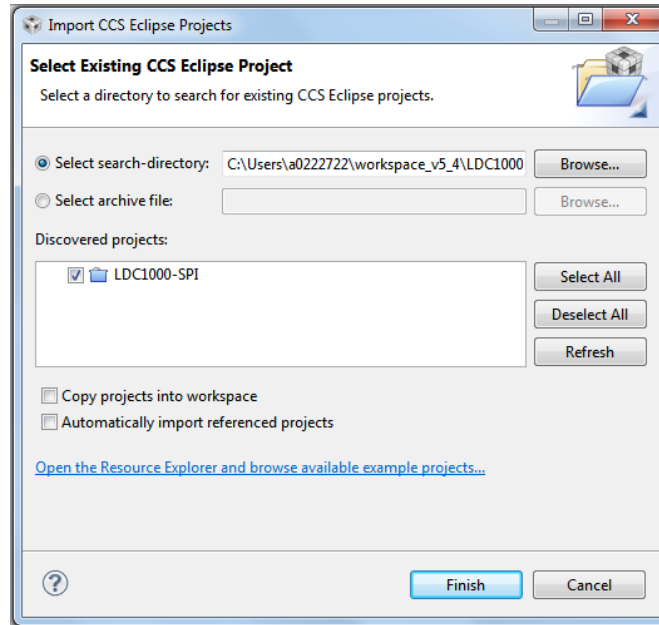


图 9 导入工程

单击“build”编译，完成后单击“Debug”进行程序下载。

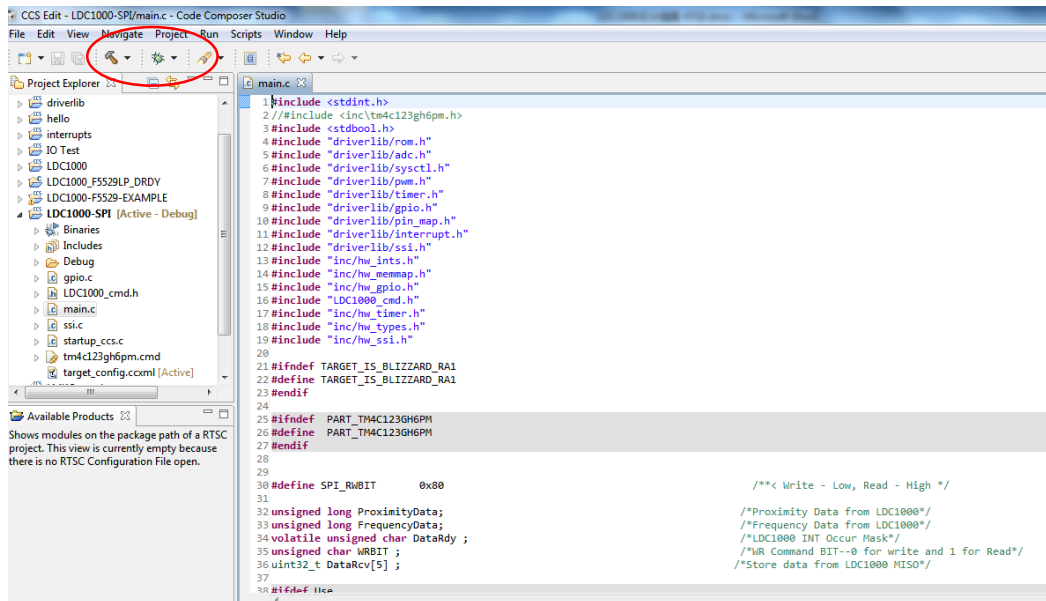


图 10 编译工程

注意：在该例程中使用了 TivaWare 软件，所以在使用前先确保电脑上已安装 TivaWare。如果编译无法通过，请检查以下步骤：

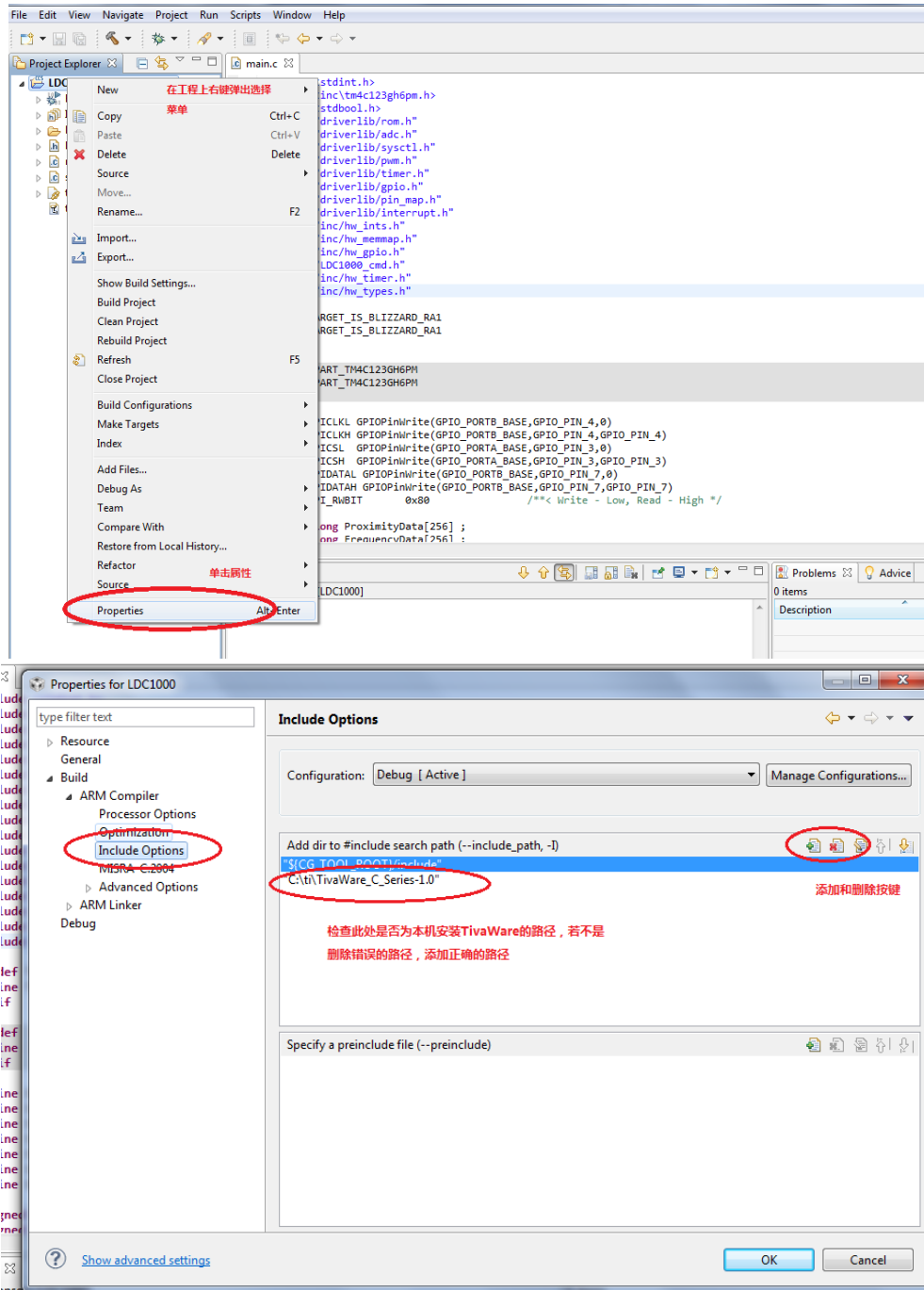


图 11 包含路径设置

同上，进行 link 路径库文件路径的检查

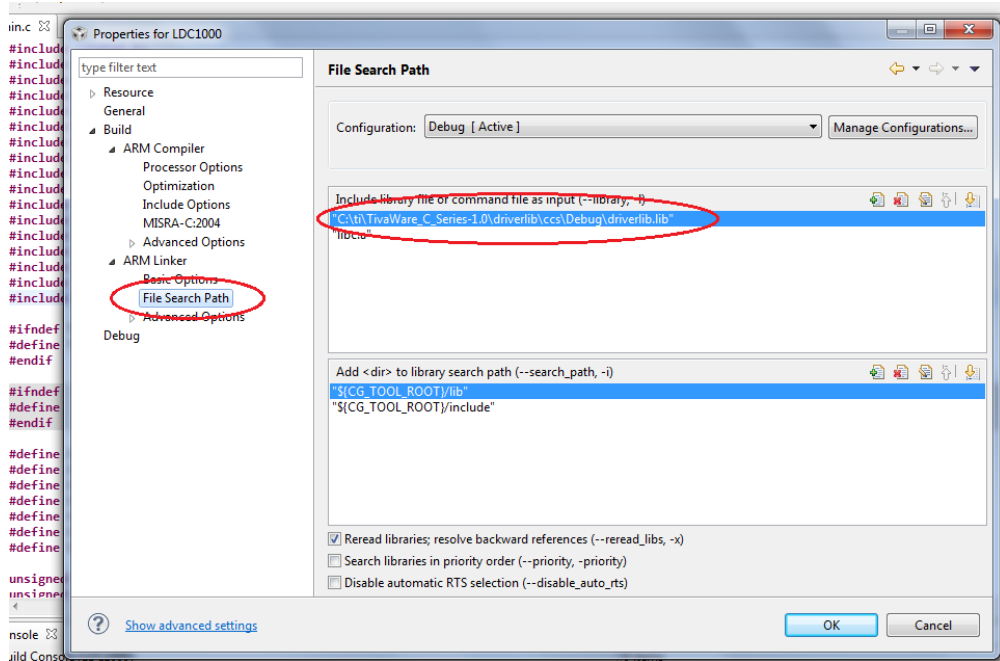


图 12 链接路径设置

### 2.3.2 函数说明

LDC1000 与 TIVA 的通讯接口为 SPI，在前文的连接方式下（UCB1），参考以下步骤进行配置。选用 TIVA 中 SPI 接口进行数据处理。SPI 初始化过程：

```

/*****
 * @brief:      SPI 通信初始化
 * @param:      none
 * @return:     none
 *
 * _____|PB4 (SSI2CLK)  ---->      SCLK |
 *            |PB5 (SSI2FSS)  ---->      CSB  |
 *            |PB6 (SSI2RX)   <----      SDO  |
 * Tiva M4    |PB7 (SSI2TX)   ---->      SDI  |  LDC1000
 *            |              |
 * _____|              |_____
 *****/
/

void SPIInit()
{
    //配置 PB6 为 SSI2RX，即对 Tiva M4 而言的 SPI 数据接收线
    GPIOPinTypeSSI (GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_6) ;
    GPIOPinConfigure (GPIO_PB6_SSI2RX) ;

    //配置 PB6 为 SSI2TX，即对 Tiva M4 而言的 SPI 数据发送线
    GPIOPinTypeSSI (GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_7) ;
    GPIOPinConfigure (GPIO_PB7_SSI2TX) ;

    //配置 PB4 为 SSI2CLK 线，作为时钟线
    GPIOPinTypeSSI (GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_4) ;
    GPIOPinConfigure (GPIO_PB4_SSI2CLK) ;

    //配置 PB5 为 SSI2FFS 线，作为片选线
    GPIOPinTypeSSI (GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_5) ;
    GPIOPinConfigure (GPIO_PB5_SSI2FSS) ;
}

```

```

SSIDisable (SSI2_BASE); //禁能 SSI2

//配置 SSI2 为 SSI_FRF_MOTO_MODE_0 协议格式, SPI 主模式, 时钟源为 5K, 16 位数据长度

SSISetExpClk (SSI2_BASE, SysCtlClockGet (), SSI_FRF_MOTO_MODE_0, SSI_MODE_MASTER, 5000, 16);

SSIEnable (SSI2_BASE); //使能 SSI2
}

```

SPI 的读写时序同上 MSP430F5529, LDC-SPI 协议。

通信时遵循以下步骤:

1. 片选信号置低;
2. TIVA 通过 SDI 线向 LDC1000 写入访问寄存器地址, 其中最高位 0 表示写入, 1 表示读出, 剩余 7 位为寄存器的地址;
3. 如果命令为读, 即步骤 1 中传输的数据最高位为 1, SDO 线上发送来自其地址寄存器的 8 位字节; 如果命令为写, SDI 线接收来自 TIVA 的 8 位字节数据写入相应的寄存器中。

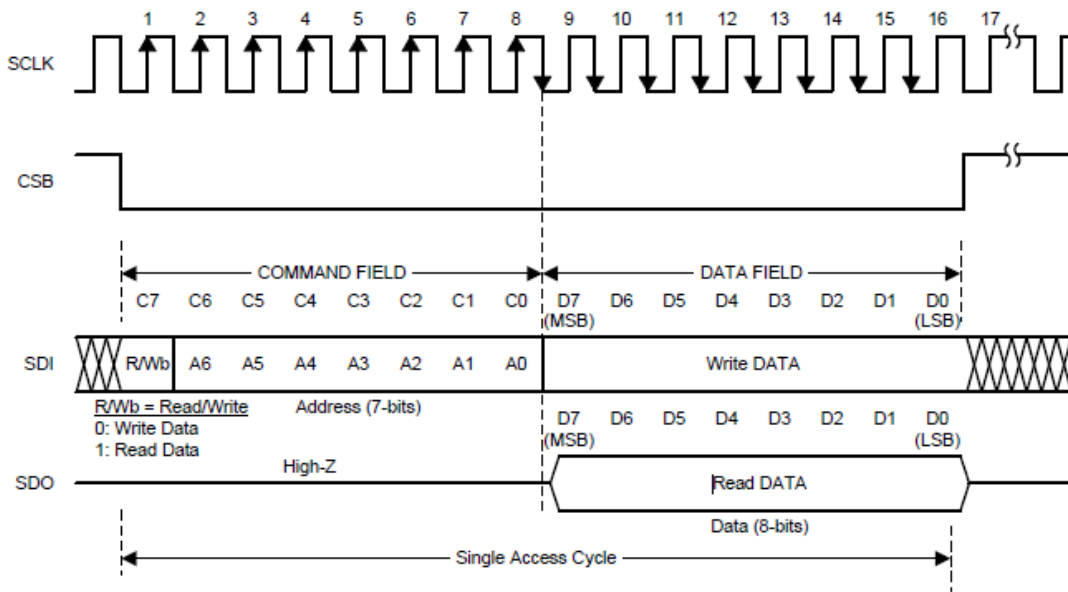


图 13 时序示意

### LDC1000 写寄存器操作

```

/*****
 * @brief:      SPI 写数据
 * @param:      unsigned int, SPIdata:待写的的数据
 * @return:     none
 *****/

/
void SPIDataSend(unsigned int SPIdata)
{

```



```

SSIDataPut (SSI2_BASE,SPIData);           //SPI 发送（写）数据
while (SSIBusy (SSI2_BASE)) ;           //等待 SPI 发送（写）完成
}

```

### LDC1000 数据读操作

```

/*****
* @brief:    SPI 读取数据
* @param:    uint8_t,ui8Add:寄存器地址
*            uint32_t,*p_ui32Data:读取值存放缓存
* @return:   none
*****/
void SPIDataRead(uint8_t ui8Add,uint32_t *p_ui32Data)
{
    SPIDataSend((ui8Add | SPI_RWBIT)<<8); //写入将要读取的寄存器地址
    SSIDataGet (SSI2_BASE,p_ui32Data);   //读取上述寄存器中的值
    while (SSIBusy (SSI2_BASE));        //等待读取完成
}

```

LDC1000 需要外部加时钟方可工作，采用 TIVA 的定时器输出作为时钟。定时器的配置如下。

```

/*****
* @brief:    Timer 初始化
* @param:    none
* @return:   none
*
* _____|_____
* Tiva M4    |PB0 (Timer CLK) ---->    TBCLK|    LDC1000
* _____|_____
*****/
/
void TimerInit ()
{
    TimerDisable (TIMER2_BASE,TIMER_A); //禁能 timer
    GPIOPinTypeTimer (GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_0);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PB0_T2CCP0); //配置 PB0 为 CCP 模式
    HWREG (TIMER2_BASE + TIMER_O_CFG) = 0x04; //选择 16-bit timer

    //配置 TimerA 周期计数 (Periodic Timer mode)
    HWREG (TIMER2_BASE +TIMER_O_TAMR) |=
        (TIMER_TAMR_TAAMS|TIMER_TAMR_TAMR_PERIOD) ;

    //加载 Timer 计数值:40, 并且设置 Match 值:20 (Timer 默认为减计数)
    HWREG (TIMER2_BASE + TIMER_O_TAMATCHR) = 20;
    TimerLoadSet (TIMER2_BASE,TIMER_A,40);

    TimerEnable (TIMER2_BASE,TIMER_A); //使能 Timer
}

```

### 3 寄存器设置及数据处理

#### 3.1 RpMIN 和 RpMAX 值设定

如前文所讲，为保证 Rp 的实际值落在采样区间内，同时又保证足够的精度，需要用户合理地设置 RpMAX 和 RpMIN 寄存器的值。可以通过实际测量的方法在两个极限条件下测出 Rp 等效的最大值和最小值。在测试仪器有限的情况下，可以简单地通过软件算法比较得到两个范围的限定值。

1. 首先通过表格选取两个合适的 RpMAX 和 RpMIN 的值写入寄存器中；
2. 将金属物体放在距离线圈最近的位置（最近位置是指用户设备结构设计的最近位置），此时涡流损耗最大，将 Rp\_Min 的值逐渐增大当 code 值接近 25000 时选择此时的 Rp\_Min。（选择 25000 是为了给 32768 最大值留有余量）；
3. 将金属物体放在距离线圈最远的位置（最远位置是指用户设备结构设计的最远位置），此时涡流损耗最小，将 Rp\_Max 的值逐渐减小，code 值接近 3000 时选择此时的 Rp\_Max。（继续减小 Rp\_Max 可以看到 code 被钳位到 0 值）。

#### 3.2 Rp 值计算公式

计算公式如下：

$$R_p = (R_{pMAX} \times R_{pMIN}) / (R_{pMIN} \times (1-Y) + R_{pMAX} \times Y), \text{ in } \Omega.$$

Where:

- $Y = \text{Proximity Data} / 2^{15}$
- Proximity data is the LDC output, register address 0x21 and 0x22.

例如，0x21 和 0x22 寄存器（两个寄存器组成 16bit 数据）的读值为 5000.

Proximity Data LSB	0x21	RO		Proximity Data[7:0]
Proximity Data MSB	0x22	RO		Proximity Data[15:8]

对照 RpMAX 和 RpMIN 的表格可以得到两者的具体电阻值，假设 **Rp\_MIN is 2.394 kΩ, and Rp\_MAX is 38.785 kΩ**

代入公式中得到：

$$Y = 5000 / 2^{15} = 0.1526$$

$$R_p = (38785 \times 2394) / (2394 \times (1 - 0.1526) + 38785 \times 0.1526) = (92851290) / (2028.675 + 5918.591)$$

$$R_p = 11.683 \text{ k}\Omega$$

#### 3.3 电感计算公式

LDC1000 测量电感频率是用测试 LC 谐振频率的方法。LDC1000 有外部的基准时钟，也是使用计数方法来做频率计。

$$\text{Sensor frequency, } f_{\text{sensor}} = (1/3) \times (F_{\text{ext}} / F_{\text{count}}) \times (\text{Response Time})$$

f<sub>sensor</sub> 是 LC 谐振频率，F<sub>ext</sub> 是外部基准时钟频率，F<sub>count</sub> 是 LDC1000 内部计数器值

Frequency Counter Data LSB	0x23	RO		ODR LSB
Frequency Counter Data Mid-Byte	0x24	RO		ODR Mid Byte
Frequency Counter Data MSB	0x25	RO		ODR MSB

Response time 是寄存器设定的一个值 (0x04)

LDC Configuration	0x04	R/W	0x1B	Reserved(000)	Amplitude	Response Time
-------------------	------	-----	------	---------------	-----------	---------------

将上面公式左右分别求倒数:

$$1/f_{\text{sensor}} = 3 * F_{\text{count}} / F_{\text{ext}} * (1/\text{Response time})$$

将 response time 移动到等式左边:

$$\text{Response time} * 1/f_{\text{sensor}} = 3 * F_{\text{count}} * 1/F_{\text{ext}}$$

这样看就很清晰了,  $1/f_{\text{sensor}}$  是 LC 谐振周期,  $1/F_{\text{ext}}$  是基准时钟周期, 也就是说在 response time 个 LC 谐振周期内, 使用 LDC1000 的 Fcount 计数器记录基准时钟的个数用来推算 LC 的谐振频率。

根据  $f_{\text{sensor}} = 1/\sqrt{2 * \pi LC}$  计算出 L。(C 是电路设计中的已知量)

$$L = 1/[C * (2 * \pi * f_{\text{sensor}})^2],$$

### 3.4 输出数据速率

输出数据速率跟 LC 的谐振频率有关, 手册中给出的计算方法如下:

$$\text{Output data rate} = (f_{\text{sensor}}) / (\text{Response Time} / 3), \text{ Sample per second (SPS)}$$

回顾一下电感测量里的分析, 我们可以更清楚的看出数据速率的物理意义, 电感测量中给出的谐振频率公式如下:

$$f_{\text{sensor}} = (1/3) * (F_{\text{ext}} / F_{\text{count}}) * (\text{Response Time})$$

将 1/3 和 response time 移动到左边

$$F_{\text{sensor}} / (\text{Response time} / 3) = F_{\text{ext}} / F_{\text{count}}$$

及 output data rate =  $F_{\text{ext}} / F_{\text{count}}$

所以输出数据速率就是外部基准时钟的 Fcount 分频。

## 4 电路设计注意点

### 4.1 滤波电容选择 (CFA 和 CFB 管脚管脚间)

LDC1000 对滤波电容的选择十分苛刻, 需要选择低泄露, 温度稳定性好, 压电噪声低的电容。最优的电容值在 20pF 到 100nF 之间。电容值由 LC 的谐振时常数决定。如果使用陶瓷电容的话, class I 类的陶瓷电容可以使用, 这类电容有着很好的温度特性。电容耐压值要大于 10V。为了减小寄生参数, 滤波电容应该尽量靠近芯片, 走线要短。

这个滤波电容是 LDC1000 内部有源滤波器的一部分, 选取时应尽量小, 但是要确保有源滤波器不饱和。时常数越大, 电容值越大。也就是电感越大, 滤波电容值越大。

以下步骤可以较为方便的找到最优滤波电容。

- 1、先焊接一个电容, 带磁芯的电感一般使用 10nF, 空心电感一般使用 100pF。
- 2、上电后, 配置好 LDC1000, 将金属物远离电感线圈。
- 3、用示波器观察 CFB 管脚的波形。由于无源探头的输入电容较大, 所以推荐使用有源探头, 或者无源探头前加 1K 电阻串联。
- 4、改变滤波电容值, 直到示波器出现 1V 峰峰值的信号。信号大小跟滤波电容的倒数成正比, 所以例如 100pF 时测试信号的峰峰值为 200mV, 为了达到 1V 需要使用  $0.2V/1V * 100pF = 20pF$  的电容。

## 4.2 EVM 板掰开的方式

采用非板载 PCB 线圈的时候可以掰开 AY-LDC1000 EVM，注意：因为 PCB 板较厚，直接沿邮票孔掰开时需要较大力，且容易弄坏板，建议用刻刀或者美工到沿邮票孔上先划上一定深度的槽，再掰开。邮票孔位置如图 14 所示

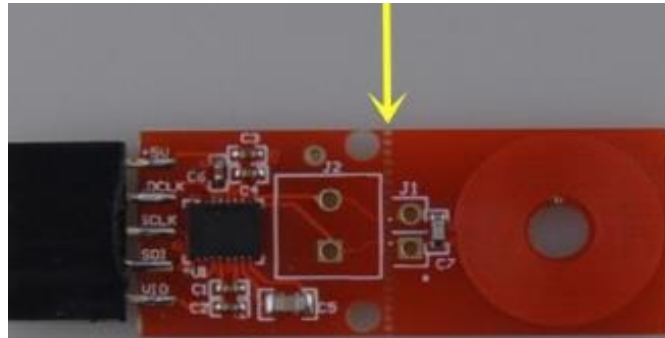


图 14 邮票孔位置

将非板载的线圈的引线连接到已经掰开的 EVM 板（掰开后焊接图 15 所示的接线柱）上即可使用。

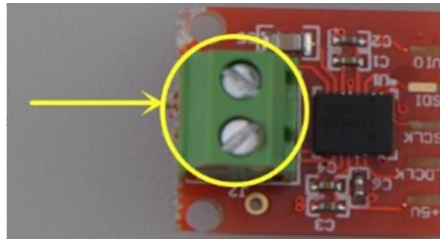


图 15 自制线圈的使用

## 5 附录

### 5.1 LDC1000 电感检测原理

LDC1000 的电感检测原理是利用大学物理中讲到的电磁感应原理。在 PCB 线圈或者自制线圈（如图 16 左边）中加上一个交变电流，线圈周围就会产生交变电磁场，这时如果有金属物体（如图 16 右边）进入这个电磁场则会在金属物体表面产生涡流（感应电流）。涡流电流跟线圈电流方向相反，涡流产生的感应电磁场跟线圈的电磁场方向相反。涡流是金属物体的距离，大小，成分的函数。

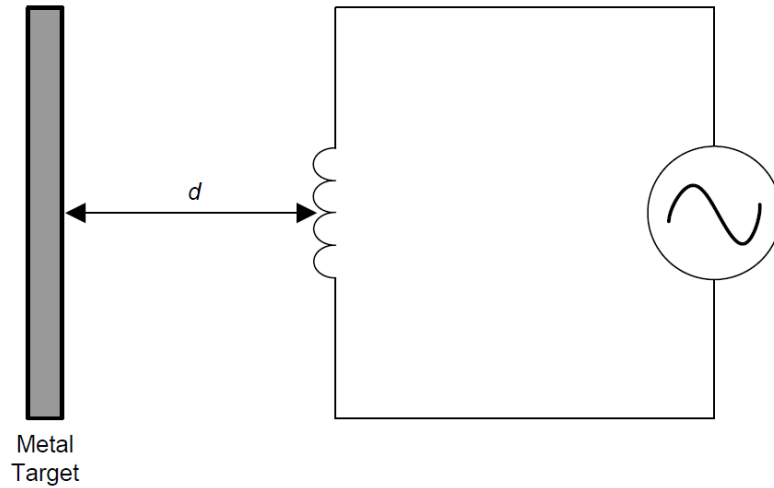


图 16 电感的感应

涡流产生的反向磁场跟线圈耦合在一起，就像是有另一个次级线圈存在一样。这样 LDC1000 的线圈作为初级线圈，涡流效应作为次级线圈，就形成了一个变压器。如图 17 所示，由于变压器的互感作用，在初级线圈这一侧就可以检测到次级线圈的参数。

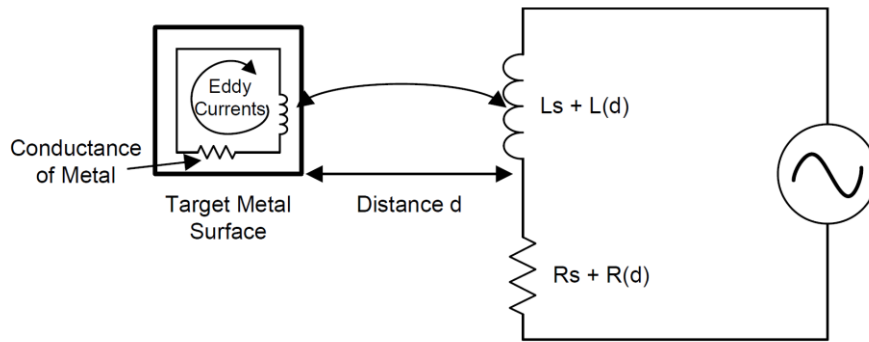


图 17 互感

上图中  $L_s$  是初级线圈电感值， $R_s$  是初级线圈的寄生电阻。 $L(d)$  是互感值， $R(d)$  是互感的寄生电阻，括号中用  $d$  是因为它们是距离的函数。

交变电流如果只加在电感上（初级线圈），则在产生交变磁场的同时也会消耗大量的能量。这时将一个电容并联在电感上，由于 LC 的并联谐振作用能量损耗大大减小，只会损耗在  $R_s$  和  $R(d)$  上。如下图所示。可以看出检测到  $R(d)$  的损耗就可以间接的检测到  $d$ 。

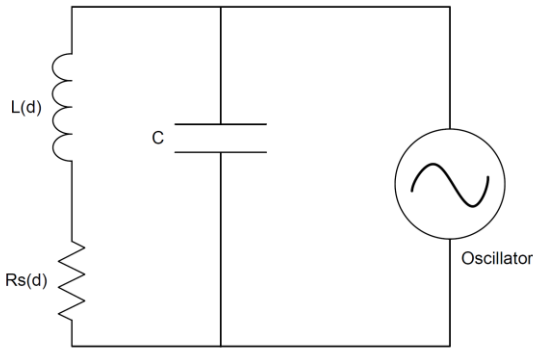
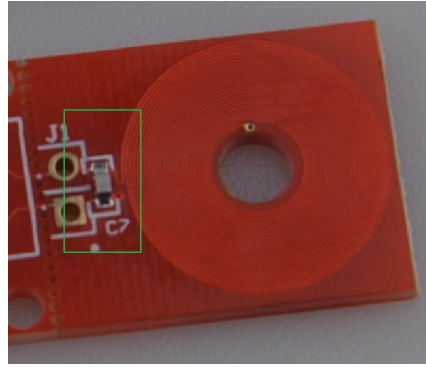


Figure 9. LC Tank Connected to Oscillator



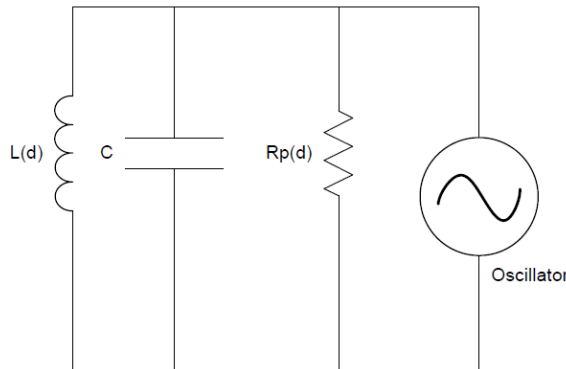
LDC1000 并不是直接检测串联的电阻，而是检测等效并联电阻。等效并联模型如下图所示，根据教科书可以得到等效并联电阻的计算公式，这里不再推导过程。

$$R_p(d) = (1 / [R_s + R(d)]) * [L_s + L(d)] * C$$

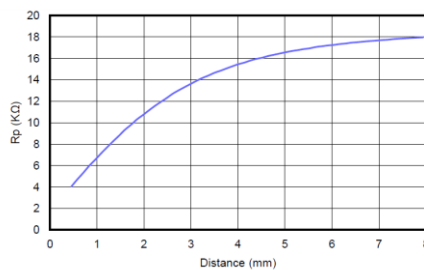
等效并联电阻

$$R_p = (1 / R_s) * (L / C)$$

外部没有金属物体时，也就是去掉跟 d 相关变量



做一个简单的测量，看一下  $R_p(d)$  和  $d$  的关系。用 2mm 厚的不锈钢金属片作为待测物体，LDC1000 的线圈使用 PCB 线圈，14mm 直径，23 圈，4mil 线宽，4mil 间距，1 盎司铜皮。变化  $d$  进行测量，可以得到如下图所示的变化规律。



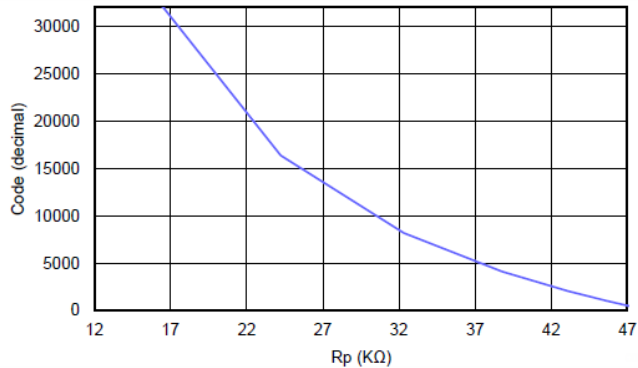
## 5.2 使用 LDC1000 测量并联谐振阻抗和电感

LDC1000 可以同时测量阻抗和谐振频率。LDC1000 是通过调节振荡器的幅度同时检测 LC 的谐振损耗来实现这个测量的。通过检测注入到 LC 谐振单元的能量，可以计算出  $R_p$ 。在 LDC1000 中  $R_p$  值被转化为数字量，数值跟  $R_p$  的值成反比。LDC1000 可以检测到 LC 的谐振频率，谐振频率用于计算 LC 中的 L 值。频率值也由 LDC1000 转换为数字量。

LDC1000 支持很宽范围的 LC 组合，也就是说支持 5KHz 到 5MHz 的谐振频率， $R_p$ （等

效并联电阻)的范围支持 798 欧到 3.93M 欧。 $R_p$  的范围可以看作是 LDC1000 内部 ADC 的信号输入范围。通过编程可以改变这个范围,注意这个范围影响 ADC 的分辨率。注:这跟用电阻分压调节 ADC 的量程一样,分压比越大 ADC 量程越宽,但是对小信号的精度越差。

下图是  $R_p$  对应的码值图。



回顾  $R_p$  的计算公式,可以看到  $R_p$  跟  $R_s$  成反比,  $R_p$  又跟 ADC 码值成反比,所以 ADC 码值跟  $R_s$  成正比。 $R_s$  跟 LC 谐振损耗成正比,所以损耗越大,ADC 输出码值越大。上图最左边当  $R_p$  小于最小设定值时,达到最大码值。这种情况是当金属物体离线圈最近的时候发生,此时涡流最大,损耗也就最大了。

下面看一下实测结果,帮助理解 LDC1000 检测  $R_p$  和 L 的过程。测试点在线圈的两级,如下图红色框。使用单端探头时要用双路测试并在示波器内求差,使用差分探头则可以直接看到波形。

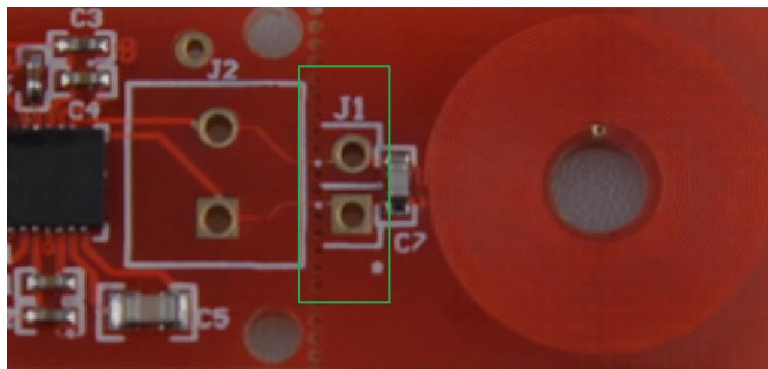
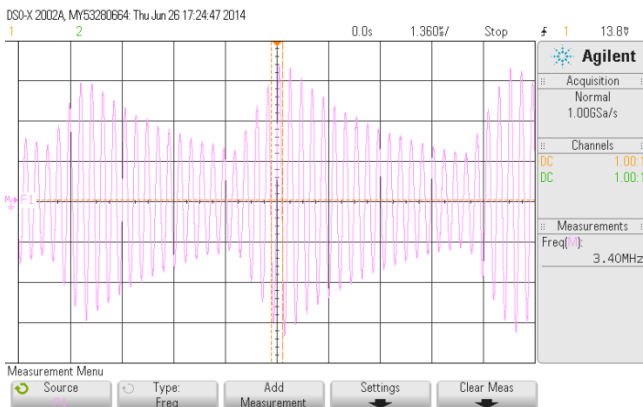
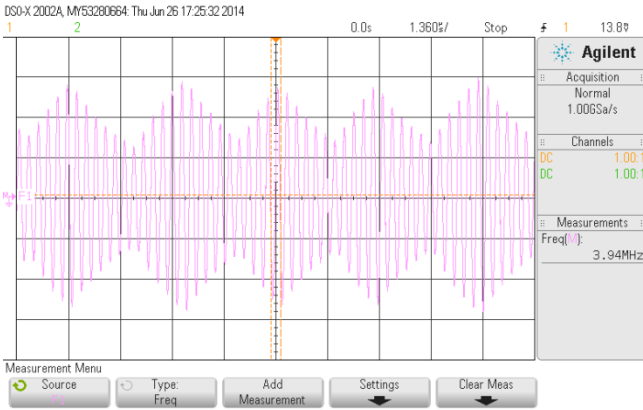


图 18 测试点





## 金属物远离线圈

### 金属物靠近线圈

可以看出实测波形是幅度有变化而正弦波，正弦波的频率是谐振频率（左图 3.4MHz，右图 3.94MHz）。正弦波的最高点是 LDC1000 向 LC 中注入能量的起点，然后 LC 开始衰减振荡，再注入能量，如此往复。金属物远离线圈时，由于没有涡流的反向磁场，线圈的电感最大，谐振频率最低。当金属物靠近时，由于涡流产生的反向磁场，使线圈的等效电感下降，谐振频率就会提高，例如图中从 3.4MHz 提高到 3.94MHz。

谐振 LC 中的 C 是已知的（电路板上焊接），所以根据谐振频率就能计算出 L 值。根据衰减振荡的曲线可以计算出  $R_p$ 。

## 5.3 参数计算

### 5.3.1 $R_p$ 的 Min 和 Max 值计算

不同的测试对象和距离会产生不同的损耗，也就是  $R_p$  的范围不同。所以应用中需要配置合适的  $R_p$  范围。LDC1000 中有两个寄存器  $R_p\_Min$  和  $R_p\_Max$  用于配置。

$R_p\_MAX$	0x01	R/W	0x0E	$R_p$ Maximum
$R_p\_MIN$	0x02	R/W	0x14	$R_p$ Minimum

应用中  $R_p$  的值如果超出这个范围就会被钳位。如果设置的  $R_p$  范围过大，真实的  $R_p$  只占这个范围的一小部分，这样就会浪费 LDC1000 内部 ADC 的精度。

手册中给出  $R_p\_Max$  的选择方法：

- 将 LDC1000 的外部线圈设置为涡流损耗最小，例如将金属物体远离线圈。
- 测试此时线圈的等效并联谐振阻抗  $R_p$ ，需要使用**阻抗分析仪**。LC 谐振组件与 LDC1000 断开测试  $R_p$ 。
- 将  $R_p$  的值乘以 2，在手册的 table 7 中找最接近的值。注意 table 7 中只有 32 个值，也就是说  $R_p\_Max$  寄存器虽然有 8bit 但只能使用 0x00 到 0x1F 的范围。

例如用阻抗分析仪测试出  $R_p$  是 18k，则  $18k * 2 = 36k$ ，table 7 中 38.785k 是最接近的。

手册中给出的  $R_p\_Min$  的选择方法

- 将 LDC1000 的外部线圈设置为涡流损耗最大，例如将金属物体靠近线圈。
- 测试此时线圈的等效并联谐振阻抗  $R_p$ ，需要使用**阻抗分析仪**。LC 谐振组件与 LDC1000 断开测试  $R_p$ 。

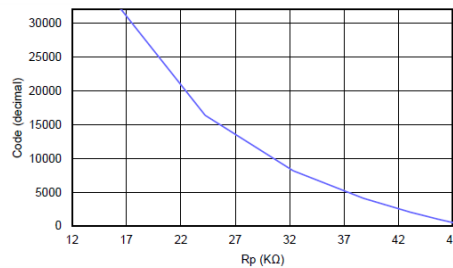


- 将 Rp 的值除以 2，在手册的 table 9 中找最接近的值。注意 table 9 中只有 32 个值，也就是说 Rp\_Min 寄存器虽然有 8bit 但只能使用 0x20 到 0x2F 的范围。

上述方法中，金属物体与 LC 的距离是应用场景中的最大和最小距离，也就是说设备的结构设计好后，这个最大和最小距离由设备的结构决定。

### 5.3.2 Rp 的 Min 和 Max 值电路意义分析

等效并联阻抗 Rp 表示的就是涡流损耗，Rs 跟涡流损耗成正比，所以 Rp 跟涡流损耗成反比。Rp 越小，涡流损耗越大。寄存器 Rp\_Max 和 Rp\_Min 是设定 LDC1000 内部 ADC 的信号调理电路的增益。Rp\_Max 决定 ADC 的下限，也就是能检测的最小信号；Rp\_Min 决定 ADC 的上限，也就是能检测的最大信号。回顾一下 Rp 跟 code 之间的关系图，Rp 决定上下限的作用更清晰。



也可以从实验中看出这个检查范围对检测精度的影响。实验说明：金属物跟 LDC1000 的线圈固定一个距离，用于比照。设定一个 Rp\_Min 值，将金属物远离，读 code 的值（0x21 和 0x22 寄存器）并平均，记为 min，然后将金属物放在固定位置，读 code 的值并平均，记为 max。然后更换一个 Rp\_Min 值，继续一次实验。可以得到下表数据。

Rp_Min Kohm	1.796	2.394	3.078	4.309	5.387	由寄存器转化的 Rp 值，控制检测的上限
min	3660	4738	6229	9127	11940	金属物远离线圈
max	3701	4825	6380	9315	12227	金属物靠近线圈，保证各次实验距离相等
差值	41	87	151	188	287	对相同的涡流损耗有不同的差值

将 Rp\_Min 的电阻值变小，可以将 ADC 量程加大，但是这样对于相同的涡流损耗量化后的 code 值位数减小，也就是精度降低。结合 Rp 和 code 的图，左边曲线变化陡峭，右边曲线变化平缓，也就是说 Rp\_Min 值对 code 的影响快，Rp\_Max 对 code 值影响慢。

## 6 原理图

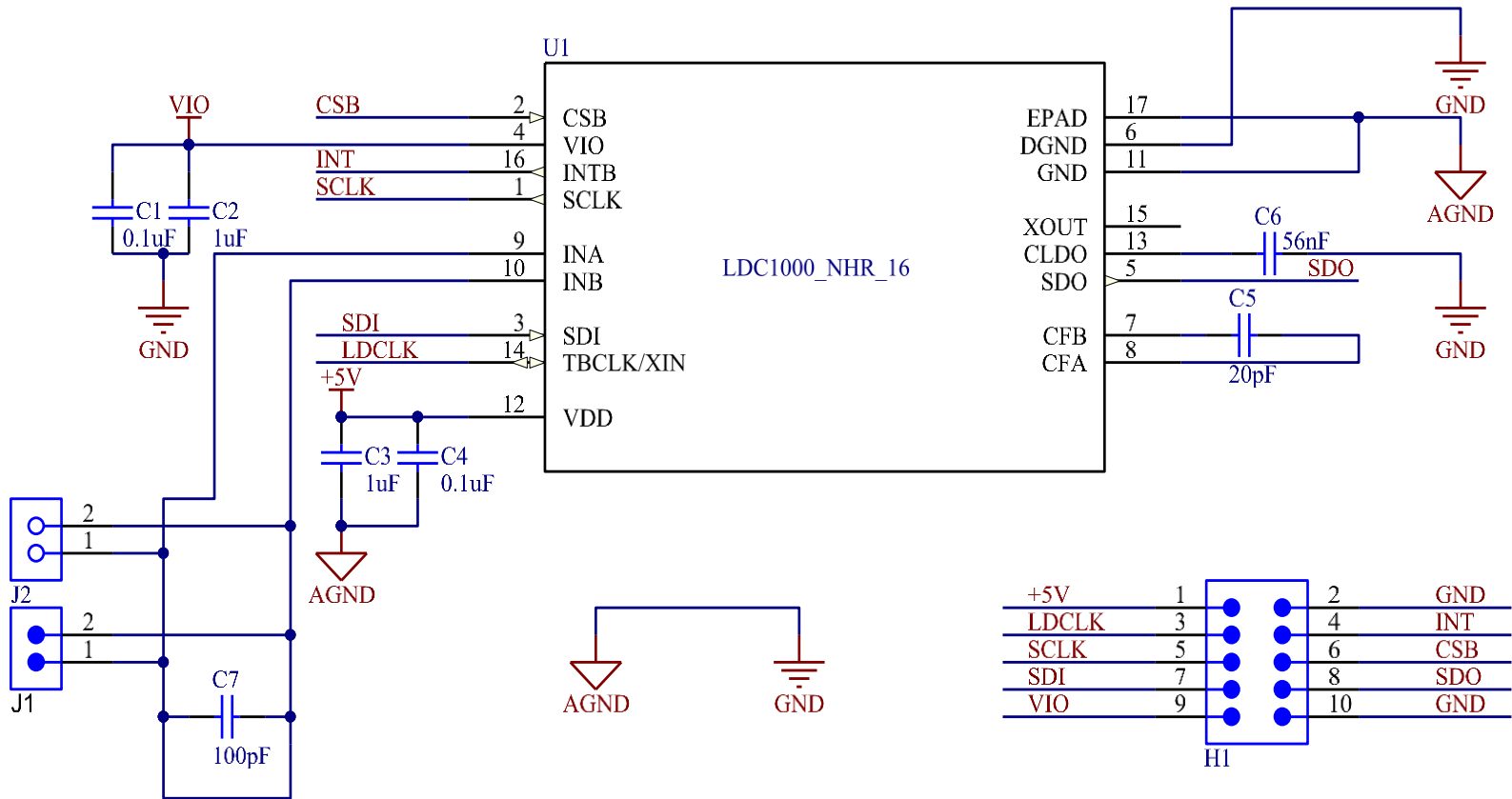


图 19 原理图